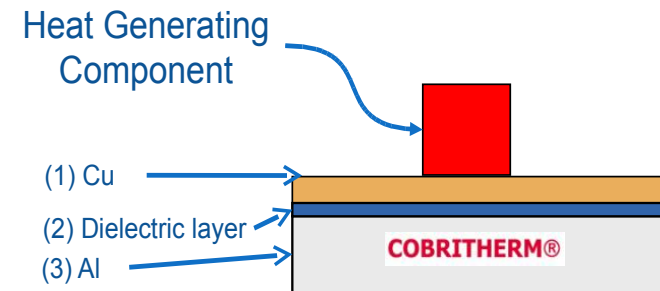
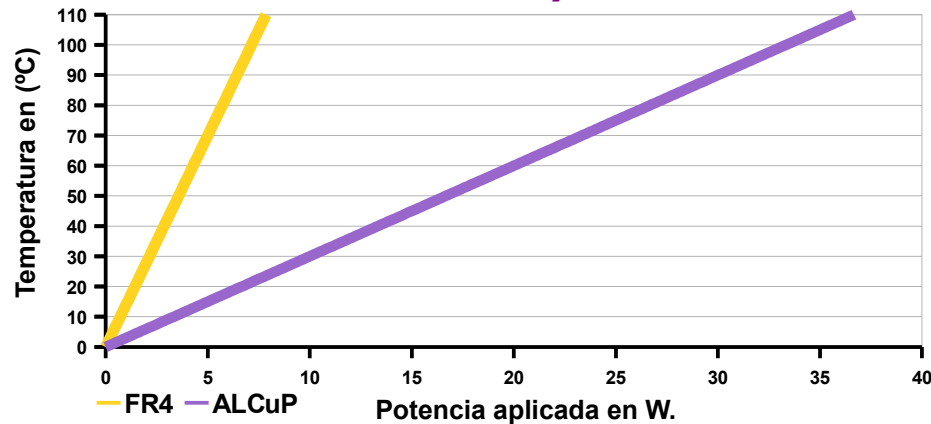

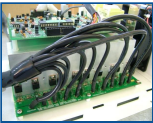



COBRITHERM ALCuP sustrato base de aluminio revestido en lámina de cobre ED. Dieléctrico formulado con polímeros de cerámica, **asegura una alta conductividad térmica, resistencia dieléctrica y resistencia térmica**. "Proof test" del 100% de la producción 2000 Vdc.

ALCuP vs FR4 disipación térmica



Aplicaciones

- Industria de la iluminación - LEDS . 
- Tarjetas de potencia - AC DC CONVERTIDORES INVERSORES, tiristores (ordenadores, HI-FI ...) 
- Industria del automóvil - Reguladores, equipos de arranque, luces. 
- Cargadores de baterías / Fuentes de alimentación.
- Energía fotovoltaica..... 

Properties <i>1500um Al/ 120 um dielectric / 70 um Cu</i>	TEST METHOD	UNITS	TYPICAL VALUES	Guaranteed values
Time to blister at 288°	IEC-61189	sec	>120	>60
Cooper peel streng	IPC-TM 650-2,4,8	N/mm	2,8	>1,8
Dielectric breackdown voltage	IPC-TM 650-2,5,6,3	kV	7	5
Proof test DC	----	V	2000	2000
Thermal conductivity (dielectric layer)	ASTM-D 5470	w/m,K	1,80	1,60
Thermal impedance (dielectric layer)	ASTM-D 5470	K,m2/w	0,067	0,075
Comparative Tracking Index (CTI)	IEC-61189	V	600	>550
Flamability according UL-94, class	----	class	V-0	V-0
Glass transition temperature (by TMA)	IPC-TM 650-2,4,24	°C	90	90
Maximun Operating Temperautre	----	°C	150	150